

TSON8-FL

TSON8-FL (扁平引脚) 是更小型 (3.3 x 3.3 毫米) 的优化热性能封装, 与标准的 SOIC 8 脚封装相比, 它的面积减小 64%, 但能提供相同的最大容许功率消耗能力。

- ▶ 该封装也被称为
 - ▷ TSON-Adv
 - ▷ PowerFLAT 3.3 x 3.3
 - ▷ TSDSON
 - ▷ miniHVSON
 - ▷ PowerPAK 1212-8
 - ▷ JEDEC: MO-240 BA

特色

- ▶ 与 SOIC 8 脚相比, 小型、优化热性能的封装具有相同的功率消耗能力, 但面积却缩小 64%
- ▶ 双铜片互连, 以提升散热效率
- ▶ 铜片 + 铜线以及多铜线可供选择
- ▶ 一站式测试与封装服务
- ▶ 绿色材料: 无铅电镀和无卤素模塑化合物

全新开发

- ▶ 双面外露式焊盘以优化热性能
- ▶ 窄锯道的薄晶圆切割
- ▶ 更大/更高密度的引脚框架条带
- ▶ 环境友好的无铅焊膏

工艺亮点

- ▶ 无电镀裸铜引脚框架
- ▶ 晶粒贴装: 55 微米薄晶粒拾取功能
- ▶ 互连: 优化电气和热性能的铜片技术。同时提供铜片 + 铜线以及多铜线选项
- ▶ 电镀: 100% 雾锡
- ▶ 打标: 激光笔

应用

TSON8-FL 适用于中功率应用, 且专为低导通电阻和高速切换式 MOSFET 而量身定制。

- ▶ 电池保护电路
- ▶ 笔记本电脑
- ▶ 便携式电子设备
- ▶ 直流-直流转换器

可靠性鉴定

Amkor 芯片封装采用成熟可靠的半导体材料。

- ▶ 全部可靠性测试包括 JSTD-020 湿度预处理, 高温储存除外
- ▶ 湿度敏感性特性: JEDEC 级别 1, 85°C/85% 相对湿度, 168 个小时, IR 回流焊 260°C 3X
- ▶ uHAST: 130°C/85% 相对湿度、无偏置、96 小时
- ▶ 温度循环: -55~150°C, 1000 次循环
- ▶ 高温储存: 150°C、1000 个小时

测试服务

Amkor 为全部功率分立产品提供完全一站式的服务。我们有能力测试各种类型的功率器件, 包括 MOSFET、双极型晶体管、IGBT、二极管和稳压器 IC/智能化电源器件。

- ▶ Amkor 的功率分立器件测试能力
 - ▷ 静态测试 (直流)
 - ▷ 动态测试 (交流、开关/Trr、电容/Rg)
 - ▷ 破坏测试 (电感负载/VSUS)
 - ▷ 热阻 (ΔVDS 、 ΔmV , 等等)
- ▶ 程序生成/转换
- ▶ 故障分析
- ▶ 可用的测试/处理技术
- ▶ 集成打标、外观检查和卷带式包装服务

TSON8-FL

标准材料

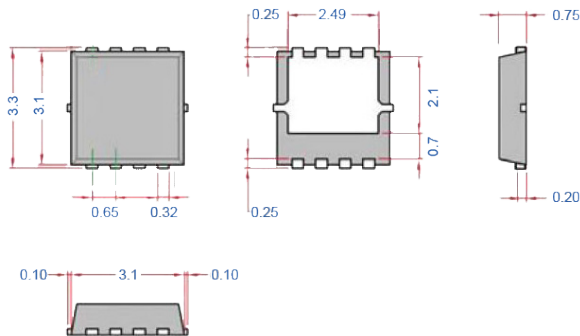
- ▶ 引脚框架：裸铜
- ▶ 晶粒贴装：焊膏
- ▶ 互连（3种选项）
 - ▷ 双铜片
 - ▷ 多铜线
 - ▷ 铜片 + 1 铜线
- ▶ 模塑化合物：无卤素

装运

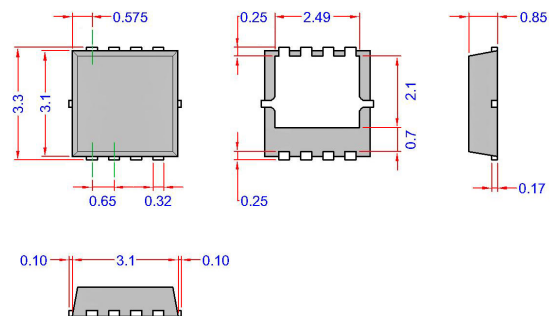
- ▶ 卷带式包装
 - ▷ 每卷 3000 或 5000 件
 - ▷ 卷带宽度 12 毫米
 - ▷ 每卷直径 = 330 毫米和 180 毫米
- ▶ 条形码封装标签
- ▶ 直接代发货

封装外形图

XDLF

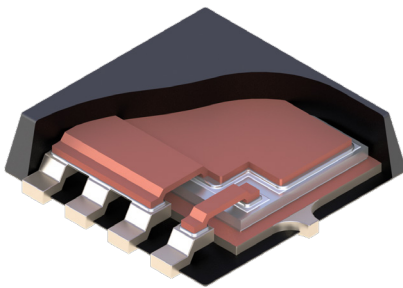


HDLF (非 XDLF)

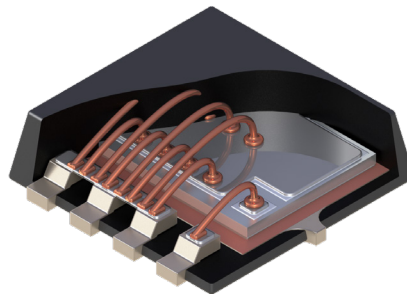


横截面

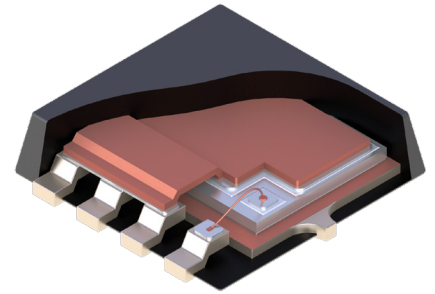
双铜片



多铜线



铜片和铜线



访问 amkor.com 或发送电子邮件至 sales@amkor.com 以获得更多信息。

关于本文档中的信息，Amkor 对其准确性或使用此类信息不会侵犯第三方的知识产权不作任何担保或保证。Amkor 对因使用或依赖它而造成的任何性质的损失或损害概不负责，并且不以此方式默示任何专利或其他许可。本文档不以任何方式扩展或修改 Amkor 其任何产品的标准销售条款和条件中规定的保修。Amkor 保留随时对其产品和规格进行更改的权利，恕不另行通知。Amkor 名称和标志是 Amkor Technology, Inc. 的注册商标。所提到的所有其他商标是各自公司的财产。© 2021 Amkor Technology, Incorporated. 保留所有权利。DS612F-CN 修改日期：02/21

